

诺德投资股份有限公司

关于增资全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟增资全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司
- 投资金额: 113,637,000 元人民币
- 不属于关联交易和重大资产重组事项,本事项尚需提交股东大会审议通过。

一、对外投资概述

惠州联合铜箔电子材料有限公司是公司全资子公司。目前公司正在对其进行停产升级扩产的相关工作。本次停产升级扩产的相关工作拟投入资金 1.15 亿元左右。为了满足全资子公司后续的扩产及营运的资金需求,并有效做大企业规模。公司拟以人民币 113,637,000 元对该子公司进行现金增资。增资后,该全资子公司注册资本为 2 亿元。

本事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

惠州联合铜箔电子材料有限公司于 2015 年 09 月 22 日成立,为公司全资子公司。基本情况如下:

- 1、公司名称: 惠州联合铜箔电子材料有限公司
- 2、办公住所: 惠州市博罗县湖镇镇罗口顺
- 3、注册资本: 8,636.30 万元人民币
- 4、法定代表人: 张贵斌
- 5、公司经营范围: 生产、销售不同规格的各种电解铜箔产品,成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制(不含电镀、铸造工序);货物、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、惠州联合铜箔电子材料有限公司一年又一期财务情况如下：

单位：元

	2015年12月31日（经审计）	2016年6月30日（未经审计）
总资产	320,537,976.98	294,394,657.67
净资产	39,401,660.52	52,346,002.33
	2015年1-12月	2016年1-6月
营业收入	120,744,247.76	258,215,993.09
净利润	-46,961,311.31	12,944,341.81

本次增资完成后，惠州联合铜箔电子材料有限公司仍为公司的全资子公司。

三、本次增资子公司的目的、风险和对公司的影响

1、本次增资子公司的目的

为了满足全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司后续的扩产及营运的资金需求，并有效做大企业规模。公司拟以自有或自筹现金人民币113,637,000元对该子公司进行增资。

2、本次增资对公司的风险和影响

公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规；顺应了新能源行业和锂电铜箔行业的快速发展，符合全资子公司升级扩产的需求，有利于做大企业规模，有利于提高公司可持续发展及增强公司在同行业中核心竞争力。符合全体股东的根本利益。请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年9月9日